****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.es](http://www.congatec.es)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Las placas base Thin Mini-ITX de congatec basadas en el procesador Intel® Core™ de 7ª generación alojan un zócalo para tarjeta SIM*

*Texto y foto también disponible online en::* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

**Nota de prensa**

**congatec lanza una minúscula placa base industrial con procesadores U Intel® Core™ de 7ª generación para dispositivos conectados a IoT**

**¡Solución de placa base de perfil bajo con alto valor añadido!**

**Deggendorf, Alemania, 7 de marzo de 2017 \* \* \*** congatec, empresa líder en tecnología para módulos informáticos embebidos, ordenadores monoplaca y servicios embebidos de diseño y fabricación, presenta la conga-IC175, una familia de placas base de grado industrial con la nueva 7ª generación de procesadores Intel® Core ™ U (Kaby Lake) diseñados para dispositivos conectados con IoT. Las nuevas placas se adaptan perfectamente a los diseños IoT de espacio limitado, alto rendimiento y baja potencia. Además de todas las mejoras de la nueva generación de procesadores, también ofrecen un soporte IoT completo que incluye un conector de tarjeta SIM para conectividad 3G / 4G o Narrow Band (NB) y las primeras versiones del API congatec IoT que se mostrarán en la feria Embedded World (Pabellón 1, stand 358).

El diseño de extremadamente bajo perfil de la nueva familia de placas base industriales Thin Mini-ITX de congatec lo hace perfectamente adecuado para diseños de sistemas delgados como GUIs (interfaces gráficas de usuario) / HMI, sistemas de señalización digital, terminales de punto de venta y tablets sanitarias. La placa impresiona debido a la implementación de la memoria ultra-rápida Intel® Optane ™, que permite arranques del sistema, arranques de aplicaciones, grabación y procesamiento de video y actualizaciones de software extremadamente rápidos. La placa admite además Hyper-Threading, que convierte el diseño de doble núcleo en un sistema 4-en-1 cuando se utiliza el hipervisor de tiempo real RTS.

"Nuestras nuevas placas base Mini-ITX Thin se pueden emplear universalmente en todas las aplicaciones embebidas e IoT, ya que las nuevas versiones de bajo consumo de los procesadores Intel® Core ™ de 64 bits de gama alta ofrecen una potencia de diseño térmico (TDP) de 15 W altamente configurable, con la flexibilidad de escalar la disipación de 7,5 W cTDP a 25 W cTDP para un equilibrio excepcional de potencia y rendimiento", explica Martin Danzer, Director de Gestión de Productos en congatec. Adaptado perfectamente para el mercado industrial embebido y robusto, el nuevo diseño estrella de placa base ofrece al menos 7 años de disponibilidad a largo plazo, así como un amplio conjunto de interfaces industriales y controladores. Gracias al soporte de integración personal de congatec, la fase de diseño está muy simplificada y se convierte en un trabajo fácil para los ingenieros OEM.

**Conjunto de características en detalle**

Las nuevas placas base conga-IC175 Thin Mini-ITX de clase industrial se suministran con 4 variantes de núcleo dual de los procesadores SoC Intel® Core™ U de 7ª generación y tienen un TDP configurable de 7.5 W a 25 W. Dos tomas SO-DIMM soportan hasta memoria DDR4-2133 de 32 GB. Para la memoria no volátil, las placas ofrecen una ranura 1x M.2 que admite la nueva memoria Intel® Optane™ que aporta una latencia significativamente menor y mayores dispositivos de almacenamiento masivo de datos. Dos interfaces 2x SATA 3.0 permiten la conexión de discos duros o SSDs adicionales. Las nuevas placas conectan el Intel® HD Graphics 620 compatible con DirectX 12 con hasta tres pantallas independientes en resolución de 4k @ 60 Hz, a través de 2x DP ++ plus eDP o canal dual LVDS. La nueva codificación / decodificación acelerada por hardware de 10 bits de vídeos HEVC y VP9 descarga la CPU, mientras que la compatibilidad con HDR hace que los vídeos sean más vibrantes y reales. El conjunto I / O de grado industrial incluye 2x Gigabit Ethernet y 1x conector de tarjeta SIM para conectividad 3G / 4G o banda estrecha (NB) M2M e IoT, 1x PCIe x4 y 1x mPCIe para expansiones genéricas, 4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 8x GPIO y 2x puertos serie COM, uno de los cuales se puede configurar como ccTalk. Un controlador integrado de gestión de la placa (BMC), audio HDA, incluyendo un amplificador estéreo, una interfaz MIPI CSI-2 para la conexión directa de cámaras CMOS de bajo coste, así como TPM 2.0 opcional, completan el conjunto de características. Las placas admiten las versiones de 64 bits de Microsoft Windows 10 y Windows 10 IoT, así como todos los sistemas operativos Linux comunes. También está disponible una amplia gama de complementos para un diseño más fácil, incluyendo soluciones de refrigeración, placas I / O y juegos de cables.

La nueva placa conga-IC175 Thin Mini-ITX se puede pedir con los siguientes procesadores:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesador** |  | **Cores / Threads** |  | **Intel® Smart Cache [MB]** |  | **Clock / Burst****[GHz]** |  | **cTDP** **[W]** |  | **Gráficos** |
| **Intel® Core™ i7-7600U** |  | **2/4** |  | **4** |  | **2.8/3.9** |  | **15/7.5/25** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Core™ i5-7300U** |  | **2/4** |  | **3** |  | **2.6/3.5** |  | **15/7.5/25** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Core™ i3-7100U** |  | **2/4** |  | **3** |  | **2.4** |  | **15/7.5** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Celeron® 3965U** |  | **2/2** |  | **2** |  | **2.2** |  | **15/10** |  | **Intel® HD Graphics 610** |

Puede encontrar más información sobre la placa Thin Mini-ITX de grado industrial de congatec en la página del producto <http://www.congatec.com/products/mini-itx-single-board-computer/conga-ic175.html>

**Acerca de congatec AG**congatec AG, con sede en Deggendorf, Alemania, es un proveedor líder de módulos informáticos industriales que utilizan los factores de forma estándar COM Express, Qseven y SMARC, así como ordenadores monoplaca y servicios EDM. Los productos de congatec pueden ser utilizados en una variedad de industrias y aplicaciones, tales como automatización industrial, medicina, entretenimiento, transporte, telecomunicaciones, prueba y medición y punto de venta. El conocimiento básico y conocimientos técnicos incluyen características ampliadas de BIOS, así como completos paquetes de soporte para placas y controladores. Después de la fase de diseño, los clientes reciben asistencia a través de una extensa gestión del ciclo de vida del producto. Los productos de la empresa son fabricados por proveedores de servicios especializados de acuerdo con los estándares de calidad modernos. Actualmente congatec tiene delegaciones en Estados Unidos, Taiwán, China, Japón, Australia, Reino Unido, Francia y República Checa. Más información disponible en nuestro sitio web [www.congatec.com](http://www.congatec.com) o via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel and Intel Core and Optane are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*